

PLUS-FIRMENVERZEICHNIS

An

Eugen G. Leuze Verlag KG

Karlstraße 4

D-88348 Bad Saulgau

www.leuze-verlag.de

Ihr Eintrag in das **PLUS-FIRMENVERZEICHNIS** bietet in

- übersichtlichen Rubriken
 - direkten Zugriff
 - auf die Lieferanten und
 - auf mögliche Kunden
- rund um die Elektronische Baugruppe.

Das **PLUS-FIRMENVERZEICHNIS** erscheint in jeder Ausgabe der PLUS.

Durch die klare Gliederung findet der Leser schnell Ihre Firmenadresse unter den von Ihnen angegebenen Rubriken.

Füllen Sie bitte dieses Formular aus, kreuzen Sie Ihre gewünschten Rubriken auf der nächsten Seite an und senden Sie beide Seiten an Eugen G. Leuze Verlag KG per

e-mail (auf Button rechts unten klicken) oder per **Fax +49/7581/4801-10**.

Ansprechpartner Leuze Verlag: Britta Reichert, Tel. 0 75 81/48 01-12, e-mail: britta.reichert@leuze-verlag.de

Ihr Eintrag:

Firmenname: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

e-mail: _____

Internet: _____

Konditionen: Der Auftrag gilt zunächst für 1 Jahr und verlängert sich automatisch um 1 weiteres Jahr, sofern keine schriftliche Kündigung vorliegt. Eine Kündigung ist jederzeit möglich. Der Grundpreis beträgt 288,- € pro Jahr und beinhaltet den Eintrag in bis zu 3 Rubriken. Jede weitere Rubrik kostet zusätzlich 96,- € pro Jahr. Die Abrechnung erfolgt aus buchungstechnischen Gründen kalenderjährlich im Voraus. Redaktionsschluss für Änderungen ist jeweils der 15. des Vormonats vor dem Erscheinungstermin. Die Preise sind ohne MwSt.

Hiermit erteilen wir den **Auftrag** zur Eintragung in das **PLUS-FIRMENVERZEICHNIS**

Grundpreis (Eintrag in bis zu 3 Rubriken) = 288,- €

Ich bestelle noch **zusätzlich** _____ **Rubrik/en** à 96,- € pro Jahr = _____,- €

Gesamt: _____,- €

Datum

Name



Kreuzen Sie hier Ihre Rubriken an!!

1. Design

- Design-Dienstleister
- EDA Soft- u. Hardware
- Scannen u. Digitalisieren

2. Leiterplattentechnik

2.1 Hersteller

- Durchkontaktierte Leiterplatten/Multilayer
- HDI-Leiterplatten
- HF-Leiterplatten
- Leiterplattenhandel
- Nichtdurchkontaktierte Leiterplatten
- Prototypen u. Muster
- Starrflexible und flexible Leiterplatten

2.2 Dienstleister

- Analysen
- Beratungsunternehmen
- Bohren/Ritzen, Laserbohren
- CAM/Plotten
- Elektrischer Test
- Laserbearbeitung Flex-Leiterplatten
- Lohngalvanik, Endoberfläche
- Plotten
- Prüfadapter Hersteller

2.3 Zulieferer

- Basismaterial für HF- und MW-Technik
- Basismaterial und Dielektrika, Kupferfolien
- Bohr- u. Fräswerkzeuge
- Chemie für die Innenlagenoxidation
- Chemie für Durchkontaktierung und Leiterbilddaufbau
- Chemie für Wasser- und Abwasserbehandlung
- Chemische Reiniger
- Entwickler-, Ätz- und Strippmedien
- Flexibles Basismaterial
- Galvano- u. Ätzresiste
- Hilfsmaterialien für Bohren/Fräsen und Verpressen

- Lötstoppresist und Hole Plugging
- Materialien für das Wärmemanagement
- Medien für die Endoberfläche
- Photo- und Presswerkzeuge

2.4 Maschinen u. Anlagen

- Absauganlagen für Späne und Staub
- Anlagenservice und Wartung
- Anlagen zur Wasseraufbereitung und Abwassertechnik
- AOI- und AXI-Geräte
- Applikation des Lötstopplacks, Beschichtungslinien
- Belichter
- Bohr- und Fräsmaschinen, Ritzmaschinen
- Bond- und Nietsysteme zur Registrierung
- Bürsten, Entgraten
- DES-Anlagen
- Durchkontaktierung und Leiterbilddaufbau
- Elektrischer Test
- Filtergeräte u. -medien
- Gebrauchtmachines
- Innenlagenoxidation
- Kunststoffverarbeitung
- Laminatoren
- Laserbohrmaschinen
- Layupsysteme für Multilayer
- Leiterplattenreparatur
- ML-Pressen
- Photoplotter
- Pluggingmaschinen
- Pressblechreinigung/Aufarbeitungsservice
- Pumpen
- Recycling von Materialien
- Selektive Metallabscheidung
- Siebdruckanlagen
- Stromversorgungen
- Transport- und Handlingsgeräte
- Trocknungsanlagen

3. Baugruppenteknik

3.1 Dienstleister

- Beratungsfirmen
- Bestückung
- Drahtbonden
- Eingabesysteme aus Glas
- Geräteentwicklung
- Gerätemontage
- Kabelkonfektionierung
- Komplettservice
- Prototypen
- Reparatur- und Reballingschablonen
- Schablonen-Spannsysteme
- SMD-Schablonen
- Test/Prüfung
- Vereinzeln von Flex-Schaltungen

3.2 Bauteile- und Werkzeuglieferanten

- Druck-Unterstützungswerkzeuge
- Lötmasken und Warenträger
- Steckverbinder und Fassungen/elektromechanische Komponenten
- Testadapter

3.3 Materialzulieferer

- Gießharze und Vergussmassen
- Klebstoffe, Wärmeleitpasten
- Lote, Lotpaste und Flussmittel, Lötkerneile
- Reinigungsmedien und -materialien
- Schutzlacke
- SMD Kleber

3.4 Maschinen u. Anlagen

- AOI, AXI und Mikroskope
- Aushärte-/Trockenöfen
- Bestückungsgeräte und -automaten
- Burn-in- und Klimaprüfgeräte
- Dispenser und Dosiergeräte
- ESD-Schutzeinrichtungen und -zubehör

- Gebrauchtmachines
- Incircuit- und Funktionstester
- Kennzeichnungs- und Identifikationsgeräte
- Lötanlagen und -geräte
- Pastendrucker

4. Packaging/ Hybridtechnik

4.1 Hersteller

- 3D-MID
- Chipgehäuse und Module
- Dickfilmschaltungen
- Hermetisch dichte Sockel/Gehäuse
- Mehrlagenkeramikschaltungen

4.2 Zulieferer

- Bonddraht
- Dickfilmpasten
- Drucksiebe
- Keramiksubstrate

4.3 Maschinen u. Anlagen

- Aushärteanlagen
- Ball Placement Maschinen
- Die- und Chipmontagegeräte und -systeme
- Dispenser und Dosiergeräte
- Drahtbonden
- Gebrauchtmachines
- Nasschemische Anlagen für stromlose Ni/Au Metallisierung
- Prüfgeräte
- Reinraumrichtungen und -zubehör
- Sieb- und Schablonendruckgeräte
- Trimmilaser
- Trocken- und Einbrennöfen

4.4 Dienstleister

- Wafer Bumping

5. Sonstiges

- Fertigungssoftware
- Logistik